



SEMISOL 2026

半導体後工程技術& ソリューション展

半導体は、電子機器・自動車・生成 AI などの先端技術に欠かせないものであり、高い信頼性と高機能が求められています。さらに、次世代半導体の高集積化により温度・電気的特性評価が重要となります。エスペックでは、次世代半導体の実用化に向けた試験課題に最適な試験装置をご提案いたします。

出展予定製品

半導体・電子部品・材料の温湿度環境下での 電気的信頼性評価

恒温恒湿器 プラチナスJシリーズ [Click](#)

省エネ機能と豊富なオプションによりお客様のご要望に合わせた装置のカスタマイズを実現した優れた恒温恒湿器です。さらに、低温度域での長期運転で消費電力が抑えられるECOタイプもラインアップしています。



エレクトロケミカルマイグレーション 評価システム [Click](#)

恒温恒湿環境と通電により絶縁劣化を加速させ、抵抗値変化を測定することで試料の絶縁信頼性を評価します。自動計測、データ収録およびデータ処理のシステム化によって、より正確で効率的な絶縁信頼性評価が可能です。

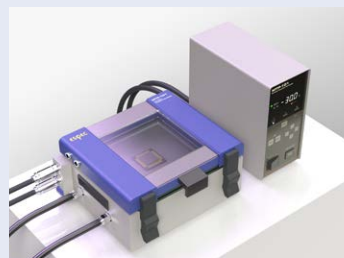


温度環境下での 電気特性・光学的変形評価

NEW

卓上型無風恒温槽 [Click](#)

無風状態で温度範囲:-30℃～+150℃を実現し、AC100V電源・省スペースで使用可能な卓上型恒温槽です。天面には大型観測窓を備え、PCと接続し専用ソフトウェアを用いることで、運転操作やプログラム運転、通信連動による制御が可能です。



熱変形計測システム / 熱画像解析システム [Click](#)

3次元デジタル画像相関法(3D DIC)やサーモグラフィを組み合わせ、温度環境下における実装基板の熱変形や表面温度分布を可視化します。受託計測サービスも承っております。



会期	2026年 6月10日(水)～12日(金) 10:00～17:00
場所	東京ビッグサイト 西3ホール ブースNo. D-05

商談予約 [Click](#) フォーム



来場事前 [Click](#) 登録のご案内



●エスペック製品や技術に関するお問い合わせは

カスタマーサポートデスク [Click](#) 0120-701-678

エスペック株式会社 <https://www.espec.co.jp/>

本社 530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6